

実装基板分割機 MAESTRO 4Mシリーズ

安定した分割作業を可能にするリニアスプリット方式を採用！
上刃(丸刃)が自動で動き、V溝ラインを正確に分断する半自動機です。

特徴

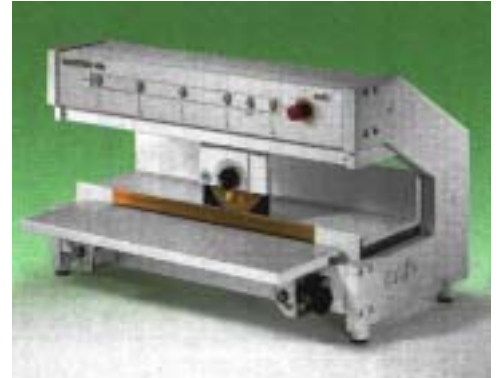
基板寸法にとられず様々な基板を迅速に分断できます。

基板が静止した状態(V溝を下刃に固定)のまま上刃(自動可動)が動いて分割するので、V溝以外の箇所を切る事はありません。

分断長さはコントロール・キーでプログラムできるため、作業の簡略に貢献します。

上下の刃間はロータリー・ノブで精密にコントロールできます。

V溝を下刃(直線刃)に固定した状態で分断するため、V溝の途中にカットアウト部が混在している基板にも問題なく対応できます。



仕様

対応するV溝仕様



A = 1.0 ~ 3.2mm B = 0.2 ~ 0.8mm
C = 0.2mm以上



分割刃(チタンメッキ仕様)

高耐久性のチタンメッキの刃が標準で付属。高寿命なので量生産工程での使用に最適。



項目		機種	MAESTRO 4M/T	MAESTRO 4MP/70
装置外観				
分割方式			リニアスプリット方式	
動力			電動モーター	
分割長さ			1 ~ 450mm	15 ~ 370mm
対応基板	・V溝残厚		0.2 ~ 0.8mm	
	・基板厚み		0.8 ~ 3.2mm	
	・部品高さ制限		V溝から19mm以内に40mm以上の背丈の部品がある基板は不可	V溝から19mm以内に70mm以上の背丈の部品がある基板は不可
電源			100 ~ 115VAC, 50/60Hz	
外形寸法			(W)702 × (D)540 × (H)434mm	(W)702 × (D)540 × (H)492mm
本体重量			38kg	40kg

カットアウト混在基板も分割できる汎用性の高いリニアスプリット方式

基板のV溝部分が下刃にしっかり固定された状態で上刃が溝を抉るように走る機構になっているため、刃がV溝以外の箇所にはみ出てカットする事故を回避できる上、V溝の途中にカットアウト部が混在する基板にも対応できます。

*上刃と下刃のギャップはロータリーノブで精密に制御できるため、刃入れ深度を自由に設定可能。上刃の可動範囲(分割長さ)の設定もできます。

ロータリーノブ

